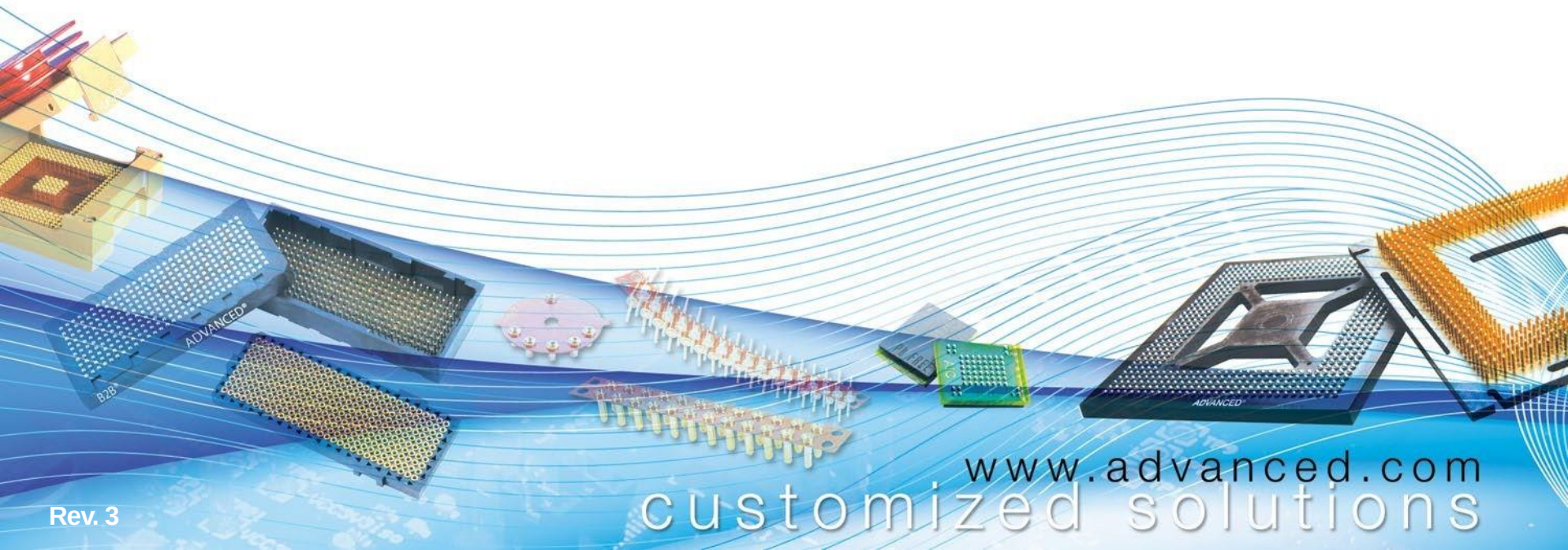
ADVANCED INTERCONNECTIONS®

アドバンスト・インターコネクションズ会社案内

カスタマイズ・インターコネクト・ソリューション



Rev. 3

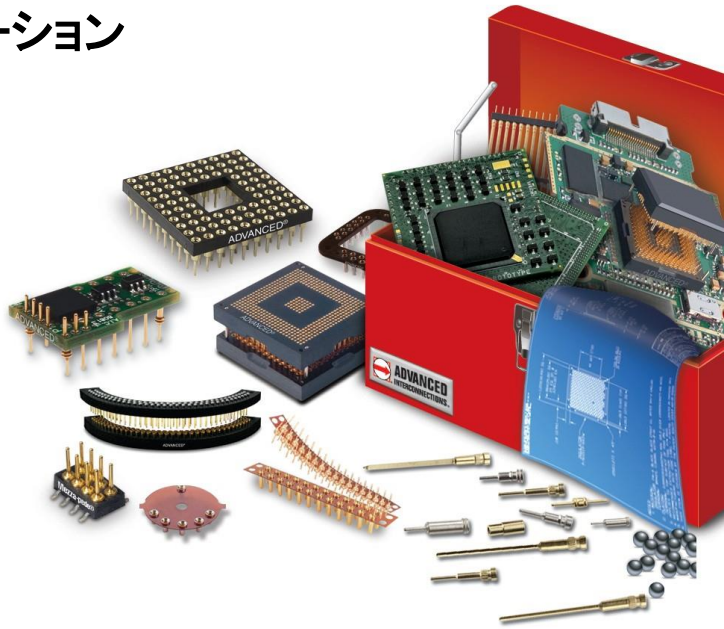
会社概要

- アドバンスト社は半導体製品の開発に必要なインターコネクト（相互接続）製品の設計、製造、カスタムソリューションを提供しております。
- ICソケット、パッケージ変換アダプタ、基板間コネクタなどには自社切削加工による高い性能の端子（丸ピン、ピンソケット）を採用しております。
- 米国ロードアイランド州でピンの生産から全て一貫性生産体制にて製造しております。
- ISO 9001:2015 認証工場ならびにITAR（国際武器取引規制）登録
- 1982年よりOEM生産などを通じ、世界各国より幅広い製品への採用をいただいております。

AEROSPACE | AUTOMOTIVE | COMPUTERS
DATA STORAGE | INSTRUMENTATION | MEDICAL
MILITARY | SECURITY | SEMICONDUCTOR | TELECOM

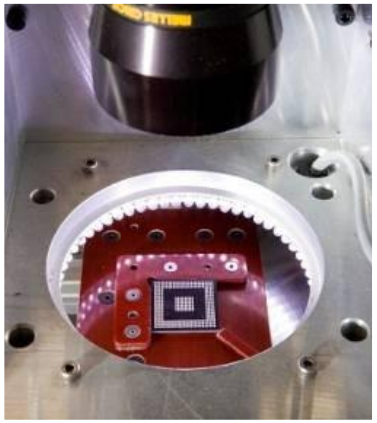
アドバンスト社にできること

- **標準品とカスタムの融合によるカスタマイズソリューション**
  - 幅広い設計応用能力
  - 500種以上の中から用途に応じて選べる端子
  - 数千種類の標準フットプリント
  - 選べるインシュレーター材料
- **経験豊富な技術者による設計支援**
  - 企画図面、サンプル、試作評価
  - シグナル・インテグリティ（SI）シミュレーションによるモデル設計



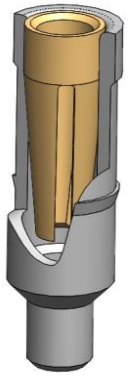
一貫生産体制（垂直的統合）

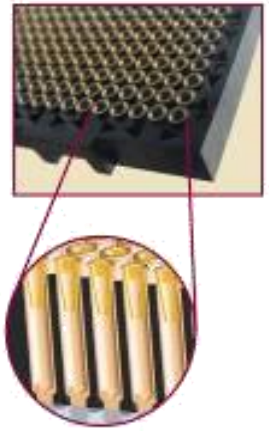
- スイス製スクリューマシンとCNC（コンピューター数値制御）切削加工技術
- 精密ドリル加工、高速射出成形、ポリイミドフィルム加工技術
  - 試作開発に合わせた小ロットから大ロット量産までの幅広い生産能力
- 表面実装（SMT）技術センター
  - リフロー実装技術、はんだボール取付設計、吸着キャップ仕様、テープリール梱包、オープン／ショート検査能力
- 徹底された工程管理
  - 自動画像検査機、レーザースキャン顕微鏡、ユーザー希望に基づいた検査工程の導入



精密切削加工

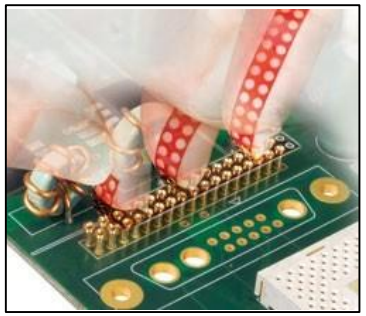
- スクリューマシンにて切削加工された高品質のピンによる高い機能と耐久性
- 冗長性の高い嵌合力を持つソケットピンとコンタクト技術
  - マルチコンタクトによる途切れの無い嵌合性
- 多彩にわたるピン形状
  - スルーホール、はんだボール（表面実装）、予はんだ仕様、ライトアングル、プレスフィット圧入ピン、ワイヤ対基板実装など





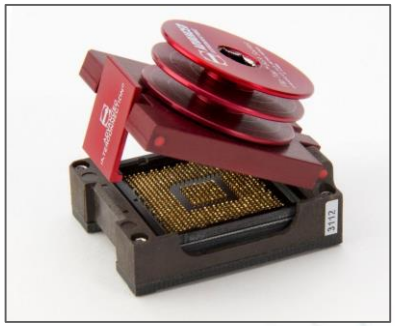
設計における挑戦を形に

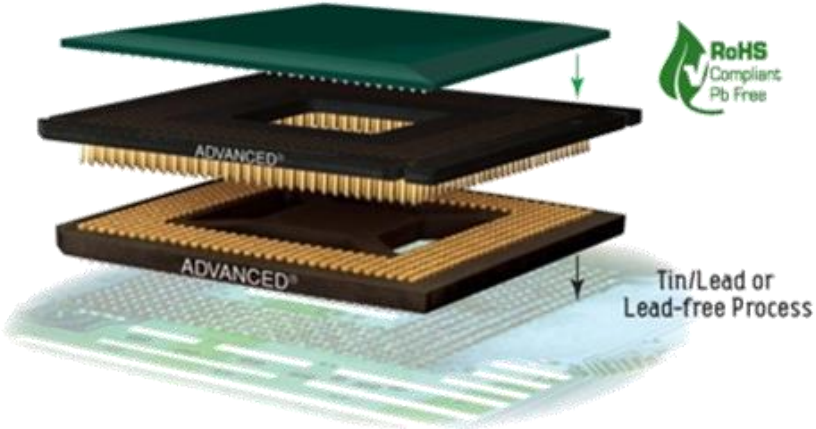
- 高価デバイス（イメージセンサーなど）のソケット化による熱ストレス減・高い費用対効果
- 交換・修理を予め予測した製品設計
- サブ基板などのスタッキング
- 製品開発選定時の評価など
- パッケージ変換
- ピン実装の自動化
- 基板の両面からのはんだ接合可視化
- 終息部品の有効的利用
- 非RoHSをRoHSへのアップグレード



BGAソケットシステム

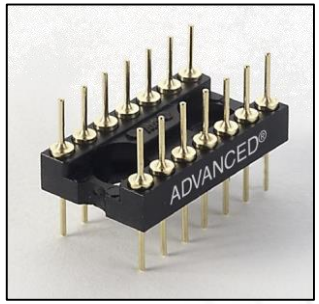
- **0.50mm ～ 1.27mm ピッチ製品**
  - BGAソケットアダプタ
  - Flip-Top™ BGA/LGA ソケット
  - 無鉛から有鉛はんだへのインターポーザー
  - パッケージ変換
  - フットプリントに合わせたモールド／FR4材を使ったインシュレーター
- **アドバンスト社独自のはんだボール技術**
  - 優れた加工技術と実績のある信頼性
  - 無鉛／有鉛はんだボールオプション
- **数千種類の標準フットプリントのオンラインデータベース**



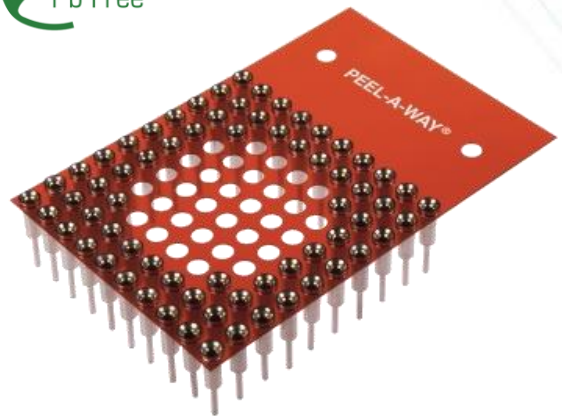


IC ソケット＆アダプタ

- **表面実装とスルーホール実装設計**
  - 精密加工された耐久性の高いマルチコンタクトソケットピン
- **モールド、FR4、ポリイミドフィルムから条件に合ったインシュレーターをお選び下さい**
- **数多くの標準品とカスタマイズ設計ソリューション**
  - Peel-A-Way® フィルムソケット
  - PGA ソケットアダプタ
  - DIP & SIP ソケットアダプタ
  - イメージセンサーソケット
  - 用途に応じたフルカスタム設計



RoHS Compliant Pb Free

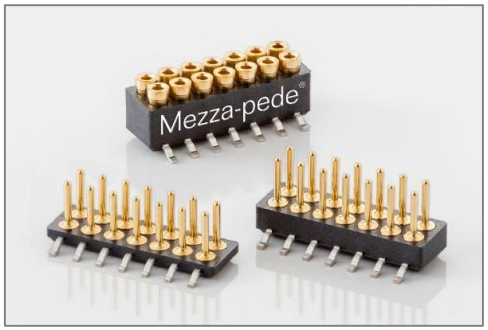


基板間コネクタ

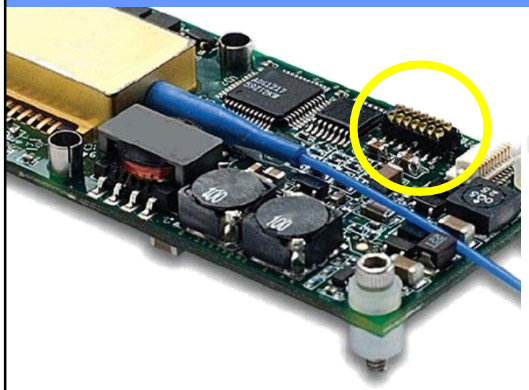
- **格子（リニア）、千鳥格子（ノンリニア）配列**
  - 表面実装、スルーホール設計
  - インシュレーターはモールド、FR-4、ポリイミドフィルムからお選びいただけます
  - 小ロット試作用から大ロット量産用まで生産可能
  - 数多くの標準品とカスタマイズ設計
- **Peel-A-Way® フィルムソケット**
  - はんだ接合部の可視化
- **B2B® SMT Connectors**
  - 高密度1.00mmピッチスタックコネクタ
- **Mezza-pede® 表面実装コネクタ**
  - 嵌合有効長3.2-4.0mm /1.00mmピッチ

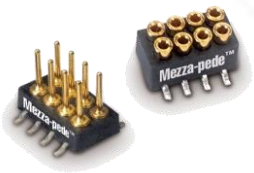
Mezza-pede® 表面実装コネクタ

- **代表的な用途**
  - 小基板のスタッキング
  - 親基板から小基板への接続
  - 波長可変レーザー基板への電源供給コネクタとして
- **実績のある信頼性**
  - 世界各国で数百万以上の採用実績
  - 耐久性の高い切削加工ソケットピンを採用した1.00mm ピッチ仕様
  - テレコディア規格ガス噴霧試験20日実施で一切の腐食無し
  - 自動実装向け吸着キャップ仕様
- **標準仕様とカスタム仕様対応可能**



APPLICATION: TELECOM

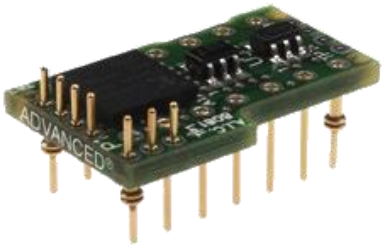


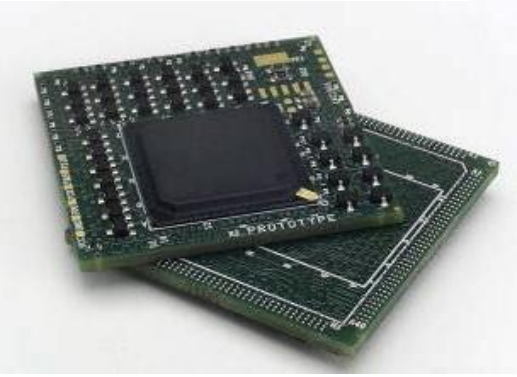


μ-ITLA波長可変レーザー基板への実績例

アダプタ＆インターポーザ

- **標準品とカスタムIC変換アダプタ**
- **スルーホールからスルーホール、表面実装からスルーホール、表面実装から表面実装などへの変換**
  - SOIC から DIP
  - QFP から PGA
  - Micro-BGA から BGA
  - PLCC から PGA
  - BGA から QFP
- **用途に合わせたカスタム設計**
  - アダプタにはICの他、設計に応じてチップなど用途に合わせてカスタマイズし、実装されたものを納品可能

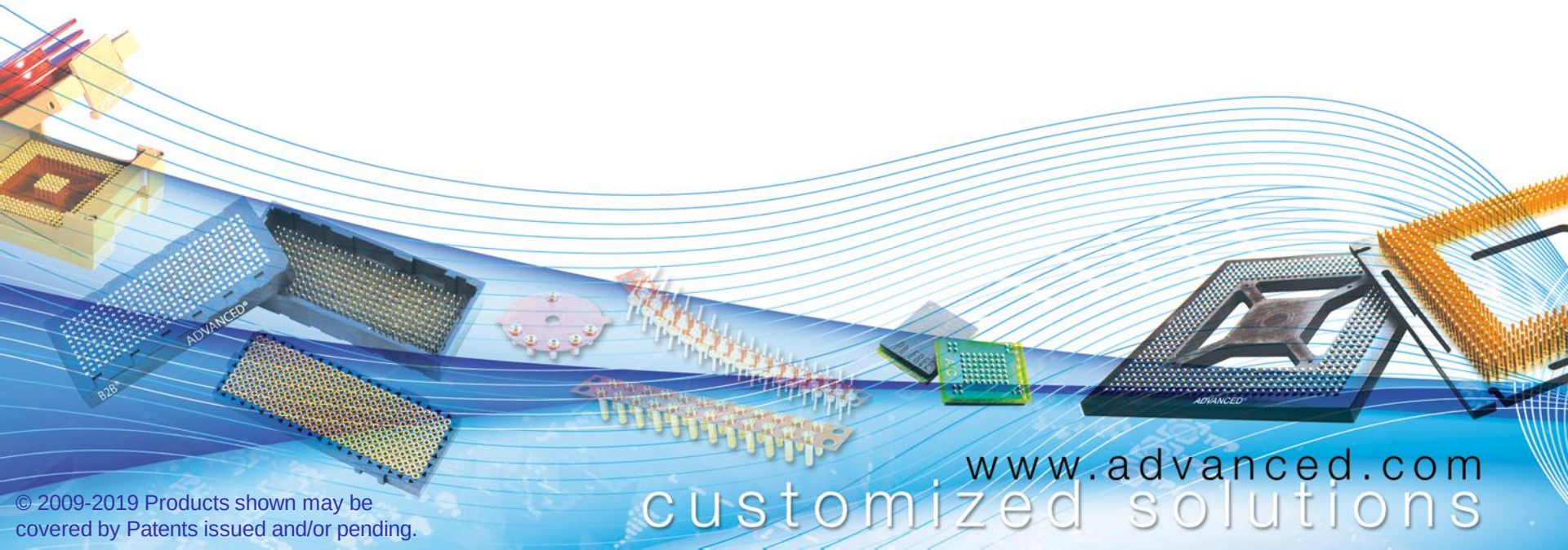




ADVANCED INTERCONNECTIONS®

“厳しい設計課題を解決するための優れた信頼性と技術を備えたインターコネクトソリューション”

それがAdvanced® の違いです。



© 2009-2019 Products shown may be covered by Patents issued and/or pending.